



# 株式会社 オプトラ

～ 半導体光学融合で未来を拓く ～

2023年12月期決算説明資料

2024年2月13日

光学薄膜装置



半導体光学融合装置



電子デバイス装置



### □ 将来の見通しについて

本資料には、「将来の見通しに関する記述」が含まれています。この記述には、当社の事業と市場における予想される成長と傾向、業界の見通しと需要要因、当社の投資と成長戦略、新製品と新技術の開発、現在および今後の事業見通しに関するものが含まれます。今後、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、予想・計画見通しと大きく異なる可能性があります。更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。

### □ 為替リスクについて

当社の主力製品である製造装置の輸出売上高は、米ドル建ての依存度が高いことから、米ドルの為替変動の影響を受けます。製造原価は中華圏生産の依存度が高いことから、中国元の変動影響を受けます。業績見通しの為替前提は、過去の実績を踏まえて想定し、為替変動影響の軽減を目指しています。当社の輸出先は中華圏の依存度が高いものの、最終需要先は米国圏の依存度が高い特徴があります。

### □ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について

当社は資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応方針として、中期経営計画の経営目標において「営業利益率」、「ROE」を定めています。株主価値の向上にむけて、安定配当と機動的・戦略的な自己株式取得を行う想定にしております。ただ、持続的な成長を見据え、積極的な研究開発、設備投資、M&Aなど含む戦略的事業提携を計画しています。問い合わせ先は、E-mail:ir-info@optorun.co.jp

### □ 23年12月期連結受注高及び業績実績

受注高はスマートフォン(以下スマホ)関連投資の減退により、前年比44%減の240億円と減速。受注減ですが、AIスマホ向け光学薄膜装置の受注獲得が始まっています。売上高はALD(Atomic Layer Deposition:原子層堆積)装置の貢献により、同7%増の368億円、営業利益は同31%増の97億円と拡大。経常利益は為替関連差損40億円の影響で同30%減の60億円。為替実績は140.67円/ドル、19.82円/人民元。

### □ 24年12月期連結受注高及び業績予想と事業環境

受注高はAIスマホ関連投資の拡大で四半期ベースの回復が期待されます。売上高は電子デバイス事業の奏効により、前年比1%増の370億円を予想。営業利益は円高や価格競争激化を踏まえて、同23%減の76億円に減少するも、経常利益は同25%増の76億円と増益を予想。為替前提は130円/ドル、20.5円/人民元。営業利益感応度は1円/ドルの円高で△1.5億円、0.1円/人民元の円高で+1億円の影響が試算されます。

### □ 中期経営計画と次期事業戦略

当社は経営目標として、営業利益率20%超、ROE(自己資本利益率)10%超を想定しています。株主価値の向上に向けて、連結配当性向30%以上を前提とする安定配当と機動的・戦略的な自己株式取得を想定しております。24/12期年間1株当たり配当金は52円(中間配当金26円)を計画。次期事業戦略において、事業領域展開に示すとおり、光学に加えて半導体光学融合や電子デバイスを事業成長の柱にする方針です。

## 光学

## 半導体光学融合

## 電子デバイス



### ■ AI スマートフォン

- ・ CMOSイメージセンサ
- ・ ペリスコープレンズ

### ■ EV/コネクテッドカー

- ・ ADAS(先進運転支援システム)
- ・ 統合コックピット/モビリティ



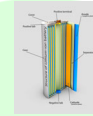
### ■ 光電融合デバイス

- ・ データコムトランシーバ
- ・ ボード接続用デバイス

## 生成AI革命

### ■ 空間コンピュータ

- ・ Micro LED/LiDARセンサ
- ・ OLEDディスプレイ



### ■ グリーンエネルギー

- ・ パワー半導体
- ・ 全固体電池

### ■ 通信デバイス

- ・ ミリ波デバイス  
(BAW/SAW/RF)



## 受注高及び業績



図表1: 受注高、業績及び1株当たり指標・財務指標(単位: 百万円、円、%)

項目	決算期	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12	24/12E	前年比%	
									23/12	24/12E
受注高		39,821	36,062	28,606	35,435	43,124	24,080	-	-44.2	-
受注残高		39,228	32,468	23,583	28,126	36,947	24,219	-	-34.4	-
売上高		44,763	42,822	37,491	30,892	34,304	36,807	37,000	7.3	0.5
営業利益		10,690	10,879	8,628	7,025	7,449	9,752	7,500	30.9	-23.1
経常利益		10,993	11,031	8,610	7,901	8,763	6,051	7,600	-30.9	25.6
当期純利益		7,746	9,102	6,797	6,330	6,890	4,632	5,400	-32.8	16.6
1株当たり当期純利益		187.6	216.7	159.1	146.8	159.0	106.1	123.2	-33.2	16.1
1株当たり配当金		55.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	52.0	0.0	4.0
1株当たり純資産		676.2	821.1	919.0	1,066.0	1,199.1	1,285.3	-	7.2	-
売上高総利益率		39.0	41.3	39.2	43.3	43.6	50.1	-	6.6	-
売上高営業利益率		23.9	25.4	23.0	22.7	21.7	26.5	20.3	4.8	-6.2
自己資本利益率		30.6	29.0	18.3	14.8	14.0	8.5	-	-5.5	-

注: 会計は日本基準、Eは当社予想、数値は百万円以下を四捨五入で算出、利益率の前年比%欄は前年比増減  
23/12期の当社予想(23年2月13日時点)は355億円、営業利益86億円、経常利益86億円、当期純利益62億円、1株当たり当期純利益142.6円

受注高は、スマートフォン関連投資の減退により、前年比44.2%減の240億円になりましたが、AIスマートフォン向け光学薄膜装置の受注獲得が始まっています。売上高は、ALD装置の貢献により増収となり、7%増の368億円でした。営業利益は、収益性の高いALD装置の寄与で増益率が高まり、31%増の95億円になりました。経常利益は、為替関連差損の影響で減益を余儀なくされました。30%減の46億円となりました。為替実績は、1ドル140.67円、1人民元19.82円でした。

スマートフォン市場は、需要の成熟化により代替サイクルが長期化しましたが、2023年第4四半期から、AIスマートフォンの登場・販売好調により、顧客からの新型装置の引き合いが高まっています。半導体光学融合領域におけるAR/VRエッチング装置や、電子デバイス領域におけるグリーンエネルギー分野向け装置などの受注を獲得しました。売上高では、ALD装置などの寄与により新型装置比率は44%と前年に比べ高まりました。

## 貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書



図表2: 主な貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書の概要(単位: 百万円)

項目	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12
現金・預金	15,741	26,970	22,723	32,274	34,923	33,054
受取手形・売掛金	6,417	3,902	9,426	5,627	7,423	4,882
棚卸資産	24,487	15,173	11,147	12,855	20,430	17,989
流動資産	48,142	47,194	44,572	53,145	65,401	57,632
固定資産	7,502	9,315	9,755	11,529	17,515	20,859
総資産	55,644	56,509	54,327	64,675	82,916	78,491
支払手形・買掛金	1,653	2,735	1,703	3,246	4,785	1,284
短期有利子負債	757	510	489	472	414	403
契約負債	20,109	13,989	8,922	9,831	19,060	14,743
流動負債	25,923	19,826	13,655	17,057	28,400	19,097
固定負債	1,659	1,864	1,157	1,535	2,357	2,478
純資産	28,063	34,819	39,515	46,084	52,159	56,916
営業キャッシュ・フロー	9,572	16,233	-535	10,686	8,561	3,180
投資キャッシュ・フロー	-2,964	-2,432	-1,048	376	-4,396	-3,599
フリーキャッシュ・フロー	6,608	13,801	-1,583	11,061	4,165	-419
財務キャッシュ・フロー	-10,054	-2,359	-2,467	-2,735	-2,172	-2,207

注: 数値は百万円以下を四捨五入で算出、受取手形・売掛金は貸倒引当金を考慮、短期有利子負債は短期借入金とリース債務の合計

資産サイドの売掛金、棚卸資産は、前年と比べて減少しており、負債サイドの契約負債、前受金もそれと見合う形で減少しました。

キャッシュ・フローにつきまして、本社の鶴ヶ島拠点への移転と上海光馳半導体の工場建設に伴う設備投資等がありました。その結果、フリーキャッシュ・フローはマイナス4億円になりました。

## 23年12月期実績と24年12月期予想のポイント



### □ 23年12月期連結受注高及び業績実績

受注高はスマートフォン(以下スマホ)関連投資の減退により減速しましたが、AIスマホ向け光学薄膜装置の受注獲得が始まっています。売上高はALD(Atomic Layer Deposition:原子層堆積)装置の貢献により増収となり、営業利益は収益性の高いALD装置の寄与で増益率が高まりました。経常利益は為替関連差損の影響で減益を余儀なくされました。為替実績は140.67円/ドル、19.82円/人民元。

スマホ市場は需要の成熟化により代替サイクルが長期化しましたが、23年12月期4Q(10~12月)頃から、AIスマホの登場・販売好調により、顧客からの新型装置の引き合いが高まっています。半導体光学領域におけるAR/VRエッチング装置や、電子デバイス領域におけるグリーンエネルギー分野向け装置などの受注を獲得しました。売上高では新規装置比率がALD装置などの寄与により44%(22年12月期35%)に高まっています。

### □ 24年12月期連結受注高及び業績予想と事業環境

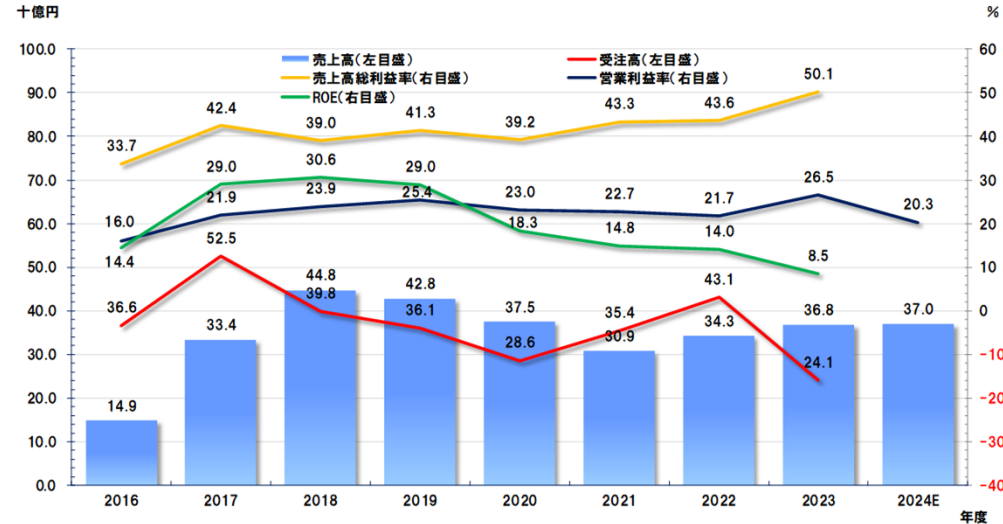
受注高はAIスマホ関連投資の拡大により四半期ベースの回復が期待されます。売上高は電子デバイス事業の奏効による小幅増収を予想。営業利益は円高や価格競争激化を踏まえて減益を予想しますが、経常利益は増益を想定しています。為替前提は130円/ドル、20.5円/人民元と現行レートより慎重に判断しています。営業利益感応度は1円/ドルの円高で△1.5億円、0.1円/人民元の円高で+1億円の影響です。

生成AI革命により、光学、半導体光学融合、電子デバイスの全事業を通じて、成膜需要拡大が期待されます。スマホ上位機種は生成AI機能搭載、カメラの複眼化・大判化による高機能化は、新規装置の需要を喚起すると予想。半導体光学融合事業は、重要注力分野と位置付け、積極的な研究開発およびIP投資やM&Aなどを行う計画です。EV/車載分野は、自動運転技術向上に伴う新たな装置需要を想定しています。

## 受注高、売上高及び収益性・収益力指標



図表3: 受注高、売上高及び収益性・収益力指標  
十億円



注: 24/12期の為替前提は130円/¥、20.5円/人民元。営業利益感応度は1円/¥で円高で△1.5億円、0.1円/人民元の円高で+1億円の影響

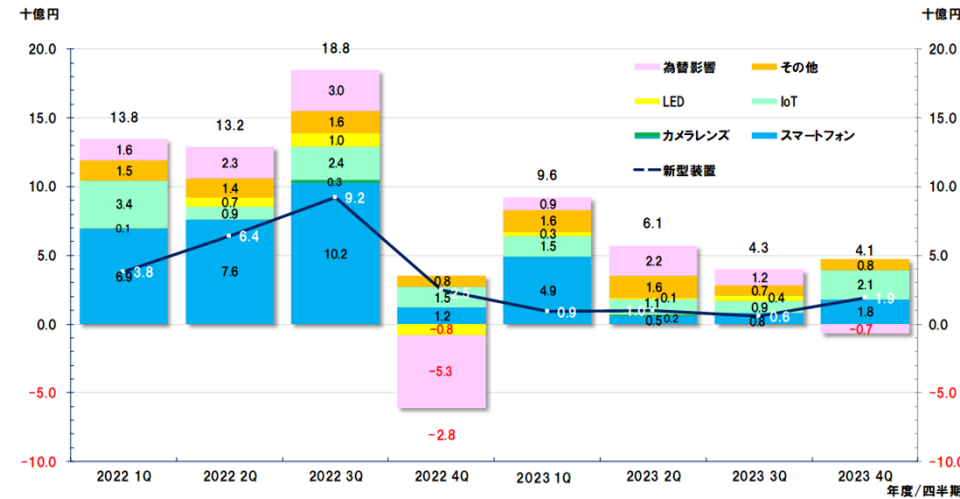
2023年につきまして、粗利は50.1%で高い水準を保ちました。これは新型装置のうち、特にALD装置の売上が大きく寄与し、営業利益率においても、26.5%と高い水準を確保できました。ROEは当期純利益が減益であったため、8.5%となりました。



## 需要分野別の四半期受注高



図表4: 需要分野別の四半期受注高



注: スマートフォンはカラー加飾膜、反射防止膜など、カメラレンズは反射防止膜など、IoTはDWDM(高密度波長分割多重)、生体認証、車載カメラの反射防止膜、AR/VRのIRカットフィルタなど、LEDはITO膜など。新型装置はALD装置を含む

需要分野別受注高の四半期推移です。

2023年第4四半期の受注高は、41億円となりました。為替の影響を除きますと47億強の受注高です。

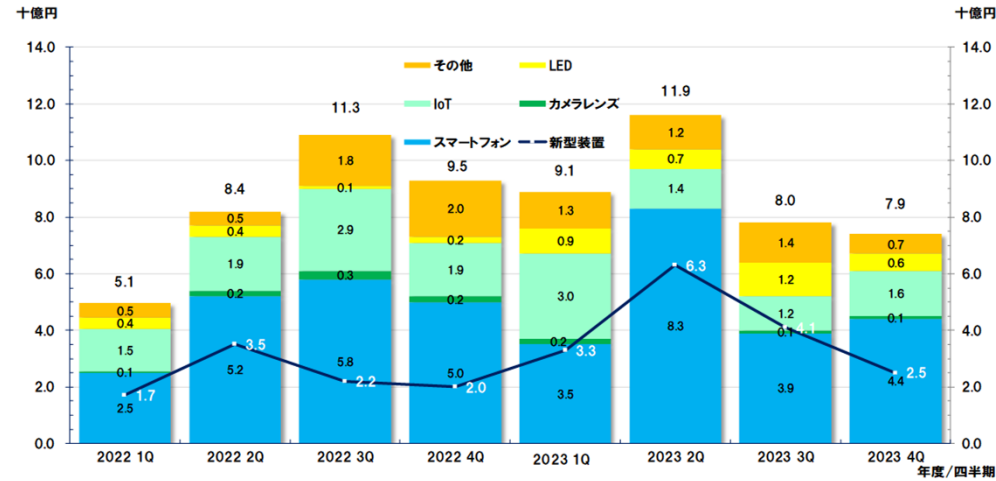
スマートフォンは、10億円の増加、中華系スマートフォンが貢献しており、受注が回復しました。また、IoT分野は車載関係を中心に、第3四半期と比べ、約11億円の増加となりました。

IOTは2023年を通じ、第4四半期は四半期別で一番高い水準となっています。全体として受注高は底打ち感が強いです。

# 需要分野別の四半期売上高



図表5: 需要分野別の四半期売上高



注: スマートフォンはカラー加飾膜、反射防止膜など、カメラレンズは反射防止膜など、IoTはDWDM(高密度波長分割多重)、生体認証、車載カメラの反射防止膜、AR/VRのIRカットフィルタなど、LEDはITO膜など。新型装置はALD装置を含む

分野別売上高の四半期推移です。第4四半期の売上高は、79億円となりました。当初の計画通りの進捗で着地しました。



# 中期経営方針

代表取締役社長 範より中期経営方針について説明いたします。



当社は設立当初から光通信・精密光学用成膜装置の開発・製造を行ってまいりました。2016年頃にはLED、化合物半導体に応用し、最近では半導体光学融合領域に位置づけられるウエハレベルオプティクス、光センサや、電子デバイス領域の通信デバイス、グリーンエネルギーへと成膜領域を拡大してまいりました。半導体光学融合領域は、光学に次ぐ事業の柱の1つとして事業展開していきます。

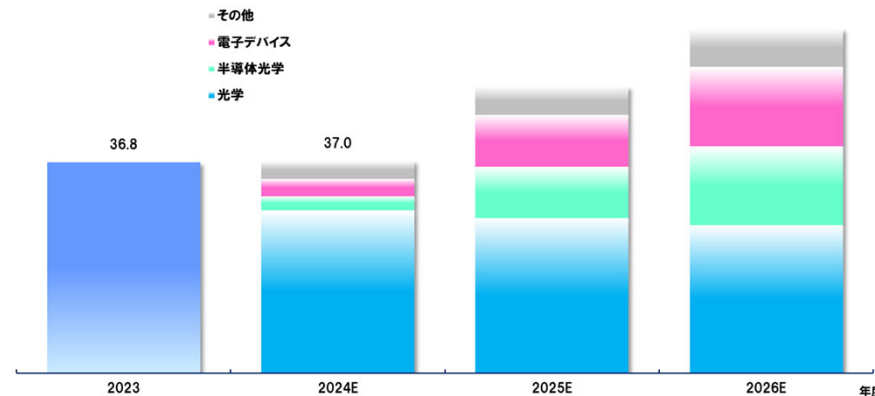
## 中期経営目標



### □ 中期経営計画と次期事業戦略

経営目標として、営業利益率20%超、ROE(自己資本利益率)10%超を想定。株主価値の向上に向けて、連結配当性向30%以上を前提とする安定配当と機動的・戦略的な自己株式取得を検討しています。24/12期の年間1株当たり配当金は52円(中間配当金26円)を計画。次期事業戦略において、事業領域展開に示すとおり、光学に加えて半導体光学融合や電子デバイスを事業成長の柱にする方針です。

図表6: 領域別中期経営目標(単位:十億円)



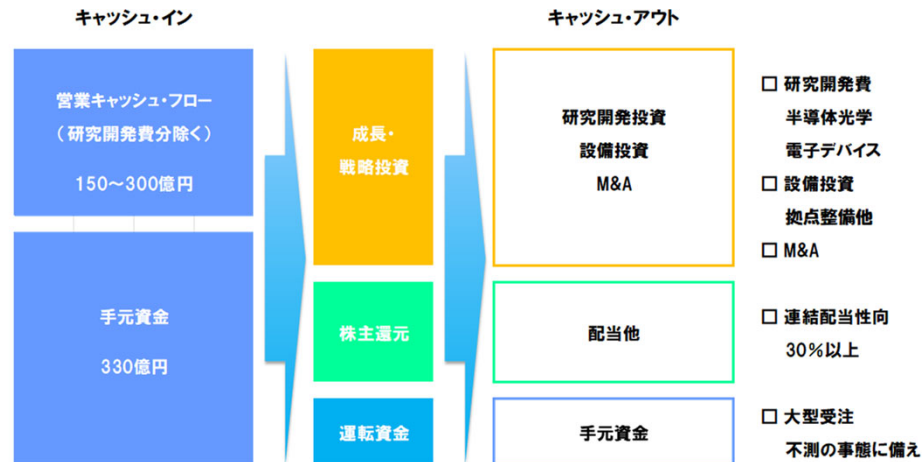
経営目標として、営業利益率20%超、ROE、自己資本利益率10%超を想定しており、株主価値の向上に向けて、連結配当性向30%以上を前提とする安定配当と機動的・戦略的な自己株式取得を検討しています。2024年12月期の年間1株当たり配当金は52円、中間配当金26円を計画しております。次期事業戦略において、事業領域展開に示すとおり、光学に加えて半導体光学融合や電子デバイスを事業成長の柱にする方針です。

2024年売上は370億円を目標としており、光学以外に、電子デバイスや半導体光学融合、サービス関連を第2の柱にする方針です。

## キャッシュ・アロケーション(3カ年)



図表7:キャッシュ・アロケーション



手元資金は330億円、3カ年の営業キャッシュ・フローは150億円～300億円、合計で500億円前後の資金残高となります。手元資金とキャッシュ・イン分を成長・戦略投資、株主還元、運転資金にアロケーションする予定です。

成長戦略投資については、主に半導体光学融合や電子デバイスをはじめとする研究開発やIP戦略、M&A等、今後の成長のために投資を行っていきます。

設備投資については、拠点整備や生産拠点整備等への投資を行っていきます。

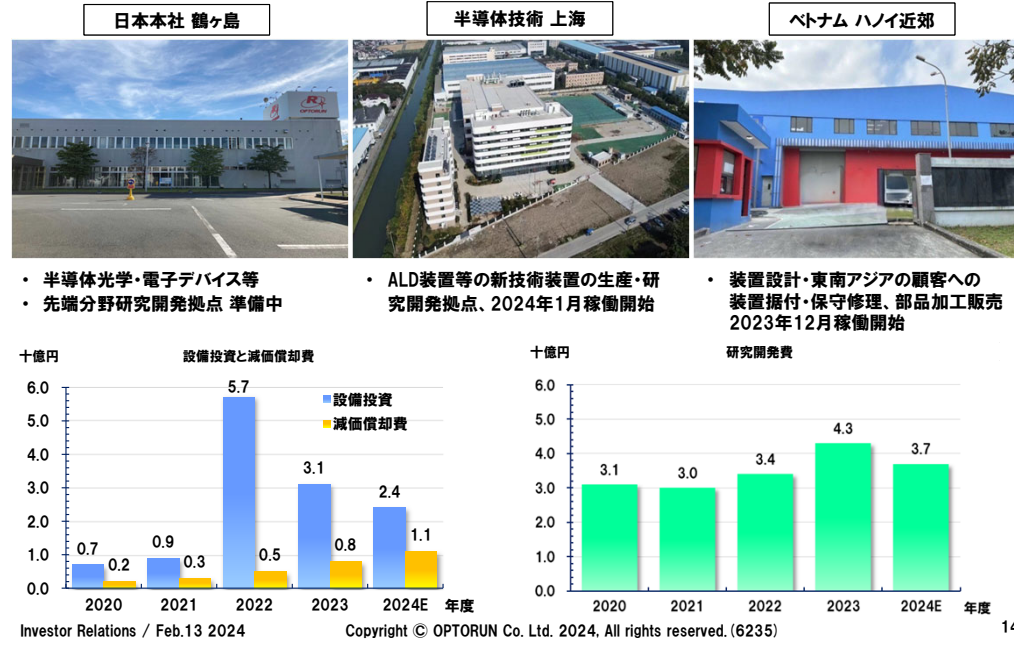
株主還元として配当金は、連結配当性向30%以上を目標としております。

手元資金については、大型受注や地政学リスク等、不測の事態に備えるため資金を残します。

## 設備投資・研究開発費計画



図表8: 設備投資・減価償却費・研究開発費



日本本社 鶴ヶ島において、2023年8月、本社の移転は完了しました。今後、先端分野研究開発機能と本社管理機能を鶴ヶ島に集約します。

半導体技術 上海において、2023年年末竣工し、2024年1月より稼働開始しました。蒸着装置以外のALD装置やエッチング装置の生産・研究開発を行います。また、大型受注を受けた際には、蒸着装置等の装置生産にも対応できるよう備えております。

ベトナムにおいて、2023年12月に稼働を開始しました。装置設計・東南アジアの顧客への装置据付・保守修理、キーコンポーネントの部品加工、販売を行う予定です。

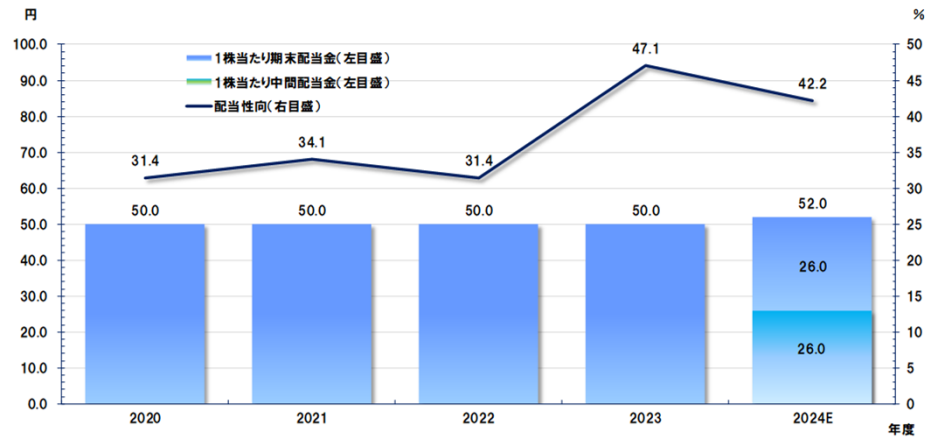
## 株主還元策・配当予想



### □ 株主還元策・配当予想

研究開発投資、生産体制強化、新事業開拓等の必要な内部留保資金を確保しつつ、連結配当性向30%以上を前提として株主還元を実施します。株主価値向上を目的として、2024年12月期より中間、期末の年2回配当を実施する想定であり、24年12月期通期配当は52円を予定しています。収益状況が大きく変動する際は、配当金を見直す可能性があります。

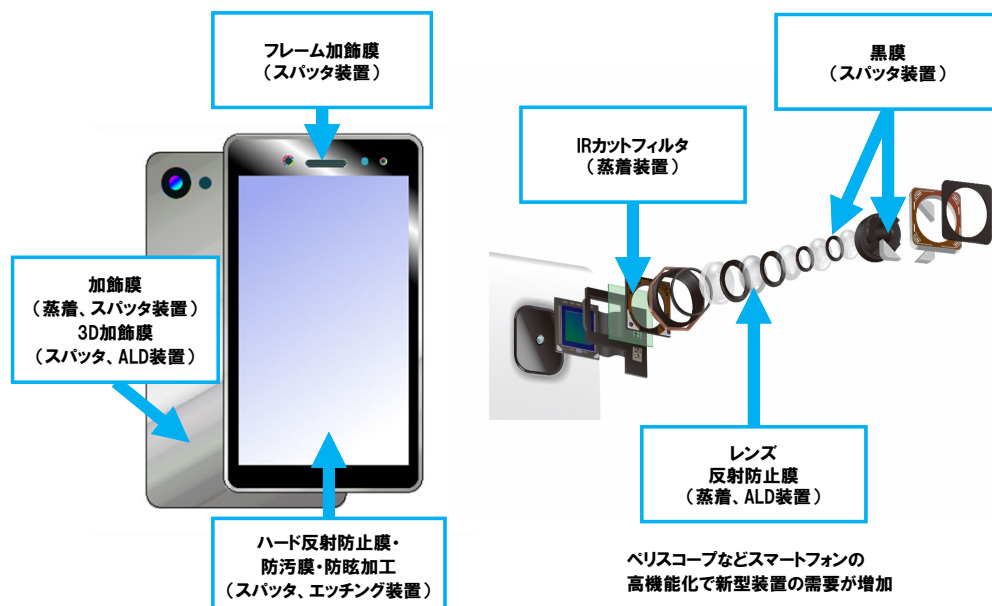
図表9: 1株当たり配当金と年間配当性向



株主還元につきましては、研究開発投資、生産体制強化、新事業開拓等の必要な内部留保資金を確保しつつ、連結配当性向30%以上を前提として株主還元を実施します。株主価値向上を目的として、2024年12月期より中間、期末の年2回配当を実施する想定であり、24年12月期通期配当は52円を予定しています。収益状況が大きく変動する際は、配当金を見直す可能性があります。



図表10: AIスマートフォン向け光学薄膜装置

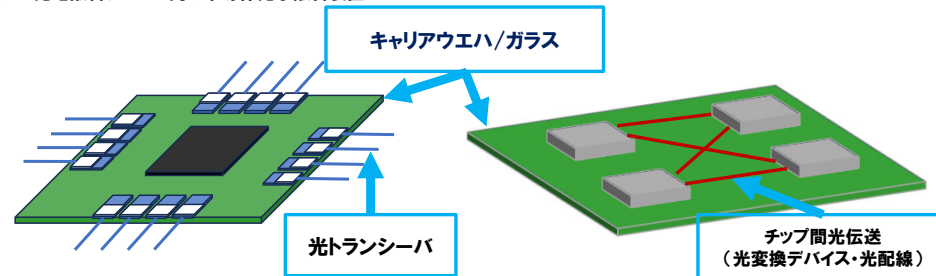


光学・半導体光学融合・電子デバイスについて、主なニーズを紹介します。  
 スマートフォン関連装置については、2017年前後に受注・売上ともにピークを迎え、直近2,3年はピークアウトしておりました。しかし、2023年後半から生成AIを搭載したスマートフォンが発売開始となり、当社装置の受注は徐々に増えてきました。  
 リアカメラは大型化、高機能化に伴い、レンズの反射防止膜やゴースト除去のための黒膜、CMOSセンサの前にある赤外線カットフィルタを成膜するため、当社装置が使用されています。  
 ディスプレイには、硬質の反射防止膜、防汚膜、防眩加工、カバーガラスには加飾膜成膜用装置が使用されており、生成AI搭載スマートフォン登場による市場回復は当社にとって大きなチャンスだと考えております。

## 半導体光学融合装置/光電融合デバイス



図表11: 光電融合デバイス向け半導体光学融合装置

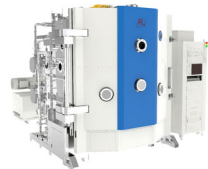


光電融合技術により、チップ間光伝送デバイスの実現に貢献へ

第2世代 光通信

第3世代 光通信

第3.5世代 光通信



蒸着装置



スパッタ装置



ALD装置

Investor Relations / Feb.13 2024

Copyright © OPTORUN Co. Ltd. 2024. All rights reserved. (6235)

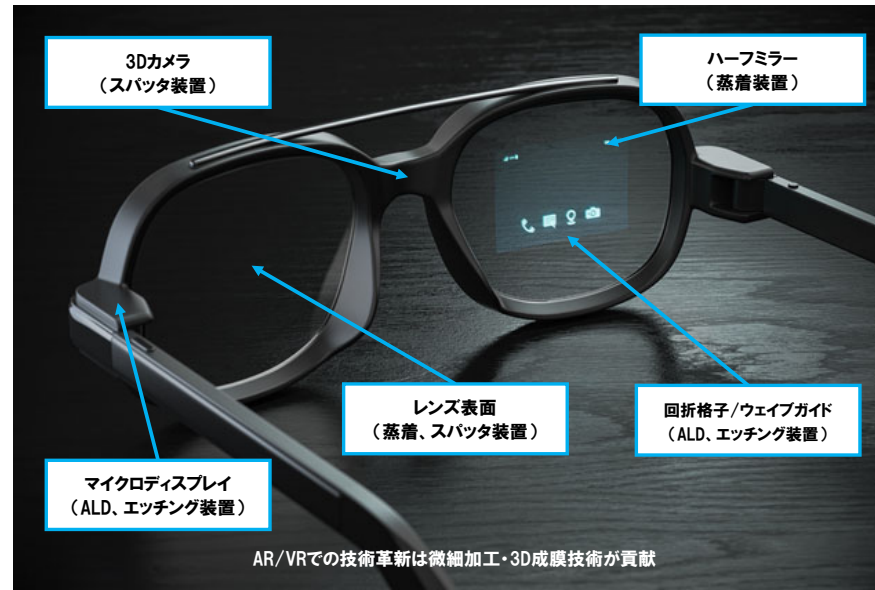
17

半導体光学融合領域の1つ、光電融合デバイス関連ニーズについて説明します。

最近のAI関連需要拡大を受けて、データセンターの処理量・処理速度向上へのニーズが飛躍的に拡大する中、チップ間光データ伝送に向けての動きが強まっております。

当社は、創業以来培った光通信フィルタ用成膜技術や、ナノリソティックス株式会社で開発中の技術等、この新たな光電融合の動きに応用できる技術を蓄積しており、今後、大きな事業機会が期待できます。新しいニーズに合わせて、光学融合装置の開発、販売を進めていきます。

図表12:空間コンピュータ向け半導体光学融合装置



続いて、半導体光学融合領域の空間コンピュータ関連ニーズについて説明します。

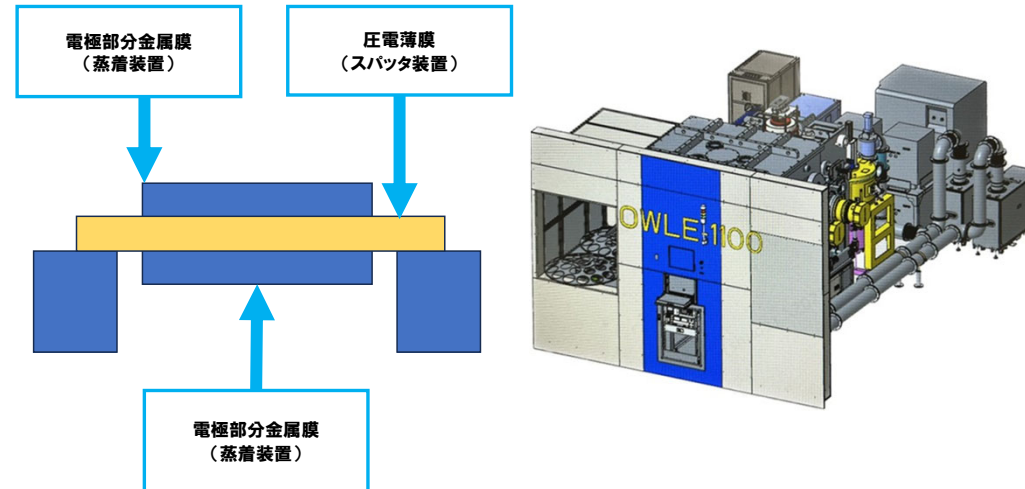
AR/VRスマートグラスには様々な成膜が必要です。

ディスプレイに必要となる回折格子にはALD装置やエッチング装置、ハーフミラーには蒸着装置が使われております。また、センサ及び加飾膜のニーズに対応できるよう装置の開発と販売に注力します。

## 電子デバイス/BAWフィルタ



図表13:BAWフィルタ(バルク表面波フィルタ)向け電子デバイス装置



注:BAWフィルタとは、Bulk Acoustic Wave Filter の略称で、2GHz以上を使う移動体通信システムで必要不可欠であり、SAW(Surface Acoustic Wave:弾性表面波)フィルタは800MHz~2GHzで使用される

電子デバイス分野では、通信用のBAW/SAWフィルタ向けの蒸着装置、スパッタ装置の開発・販売を行っております。

スパッタ装置でのBAW/SAWフィルタ向け圧電薄膜の成膜、蒸着装置での通信デバイス向け電極部分金属膜の開発を進めており、一部販売実績もあります。

更に昨年度は、グリーンエネルギー分野でのリチウム固体電池と関連したスパッタ装置の販売実績を上げました。

当社は今後、光学領域に加え、半導体光学融合領域及び電子デバイス領域と事業領域の拡大を目指し、営業利益率20%超、ROE10%超の目標に向けて邁進してまいります。

